

各位

2020年2月25日

株式会社アプリックス

(コード番号:3727 東証マザーズ)

リアルタイム組込み機器向け IoT エッジ機器開発キット EDGENGINE™ を本年 5 月に販売 ～ルネサスエレクトロニクス製マイクロプロセッサ (RZ/A2M) を搭載した シマフジ電機評価ボードを中心に構成～

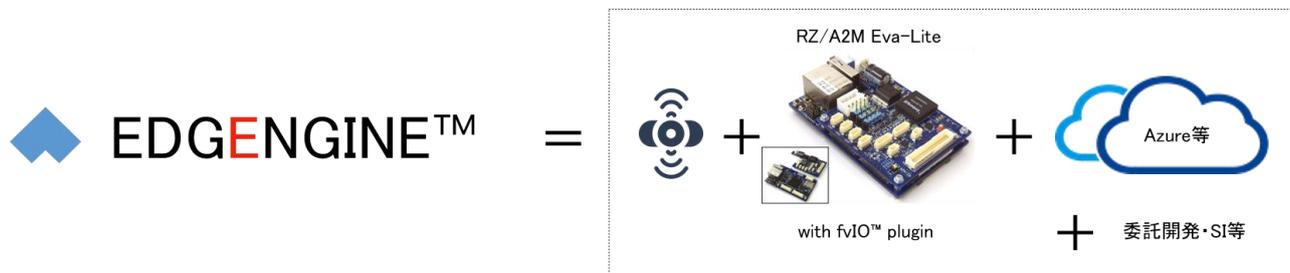
IoT (Internet of Things) 製品向けソリューションの開発を手掛ける株式会社アプリックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:根本忍、以下「アプリックス」)は、シマフジ電機株式会社(本社:東京都大田区、代表取締役:藤代巖、以下「シマフジ」)が提供する、ルネサスエレクトロニクス製マイクロプロセッサ (RZ/A2M) を搭載した評価ボードを中心に構成した、リアルタイム組込み機器向け開発環境「EDGENGINE (エッジエンジン)」を 2020 年第 2 四半期から提供する予定であることをお知らせいたします。

あらゆるモノやコトがインターネットにつながる IoT においては、生産性の向上や付加価値の高いサービスの提供を実現するために、センサ等から収集した膨大なデータをクラウドに集約し、状態の監視や感知、データ分析による予測等を行います。情報の収集場所に十分な通信環境が整っていない場合や、動画等の膨大なデータ量を処理する場合などは、従来のクラウドコンピューティングでデータを集約・処理するだけでなく、利用者により近いエリアのエッジ側でデータ処理を実行するエッジコンピューティングソリューションを組み合わせるほうが、より最適なシステムを構築できる場合があります。

アプリックスでは、こうしたネットワークやクラウドの負荷分散を行うとともに情報のセキュリティをも担保することを可能にするエッジコンピューティングソリューションで利用される機器をはじめ、モノを制御するため高い応答性能が要求されるだけでなく計算処理よりも入出力処理及び通信処理が中心となるリアルタイム組込みシステムが必要とされる状況を鑑み、機能を犠牲にせず概念実証 (PoC) に要する開発期間を短縮したいというお客様のニーズに応えるため、IoT エッジ機器開発キット EDGENGINE (エッジエンジン) を提供することといたしました。

アプリックスの EDGENGINE は、シマフジの RZ/A2M 搭載評価ボード「RZ/A2M Eva-Lite」(※詳細については[こちら](#)をご参照ください)を中心に、各種マルチセンサ及びクラウドコンピューティング環境並びにサンプルコードなどで構成されます。RZ/A2M Eva-Lite にはシマフジが開発した「fVIO 基本プラグイン」を数種類搭載するほか、当初ご提供するクラウドコンピューティング環境としては Microsoft Azure IoT Hub を、また当初サポートする RTOS (リアルタイム OS) は Amazon FreeRTOS と株式会社ユーシーテクノロジーの UCT μT-Kernel をそれぞれ想定しています。

< EDGENGINE の構成要素 >



アプリックスは EDGENGINE の構成要素としてシマフジ「RZ/A2M Eva-Lite」やパートナー企業のマルチセンサ等を販売するとともに、fVIO プラグインのカスタマイズ及びオーダーメイド開発の受注対応、Azure IoT Hub などのクラウド環境との連携はもちろん、EDGENGINE をベースとした組込み機器の開発及び搭載するアプリケーション、

制御用のスマホアプリ/タブレットアプリの開発も行う予定です。なおfIOとは、シマフジが開発したI/O端子機能仮想化技術の総称です。

今回の EDGENGINE 市場投入開始について、シマフジの取締役 犬尾 武は以下のようにコメントしています。

「アプリックスの IoT ソリューション技術と、これからますます多種多様化するセンサに柔軟に対応し、かつその性能を最大限に引き出すことが可能な fIO とを組み合わせる事により、利用用途ごとに最適な IoT デバイスを素早く実現することが可能になります。アプリックスから販売される EDGENGINE で fIO を体験頂けるようになります。これらの活動を通して、民生から産業までの幅広い分野におけるフレキシブルで高性能な IoT デバイスの普及に貢献していきたいと考えています。」

ルネサスエレクトロニクス株式会社の IoT・インフラ事業本部 エンタープライズ・インフラ・ソリューション事業部の事業部長 加藤 茂樹は以下のようにコメントしています。

「ルネサスの高性能マイクロプロセッサ RZ/A2M に内蔵された独自のハードウェアである DRP はハードウェアロジックの高い処理能力と、ソフトウェアのような高い柔軟性・機能拡張性を併せ持った IP コアです。fIO はこの DRP の可能性を引き出す技術として期待されます。今回 fIO を実装した RZ/A2M 搭載の評価キットがアプリックスから販売されることにより、エッジコンピューティングへの応用が益々広がるものと確信しております。」

アプリックスの代表取締役社長 根本 忍は以下のようにコメントしています。

「シマフジ電機と進めてきたルネサスエレクトロニクス製高性能マイクロプロセッサ向けの fIO ソリューションを今般ご提供できる運びとなったことは幸いです。アプリックスでは、今回の EDGENGINE をひとつの基軸として、リアルタイムシステム並びにクラウドを利用する IoT 関連開発のご支援はもちろん、ますます市場から必要とされるエッジでの画像認識等につきましても、お客様のニーズに即したソリューションをご提供してまいります。」

今後、アプリックスグループは、EDGENGINE を予定通り第 2 四半期中にサービス開始できるよう引き続き鋭意取り組むとともに、EDGENGINE 関連サービス等の拡充を併せて進めることで、ルネサスエレクトロニクスのマイクロプロセッサ「RZ/A」シリーズの普及と IoT エッジコンピューティング市場の拡大に微力ながら貢献してまいります。

以上

■シマフジ電機株式会社について

1990 年 11 月設立。創業時より先端デバイスを用いる機器の受託開発を行っており、マイクロプロセッサや FPGA(Field-Programmable Gate Array)を搭載した評価ボード、組込みソフトウェアの設計開発を得意とする会社です。

2004 年に開発した超小型コンピュータ「Teacube」の流れを汲む SEMB1401 や SEMB1402 に、IoT 時代の手足となる fIO を搭載することにより、組込みボードの未来を、そして人々の未来を創造していきたいと考えています。

コーポレートサイト <http://www.shimafuji.co.jp/>

■株式会社アプリックスについて

アプリックスの使命は「ソフトウェアの力で世の中のあらゆる人々に幸せをもたらすこと」です。携帯電話での Java 利用という新しいフロンティアを切り開いた「JBlend」に続き、開拓中の分野が、IoT(Internet of Things)です。当社では IoT モジュール(ビーコン)、スマホアプリ、クラウドサービス等の IoT ソリューションを一貫して提供することで、家電製品等の IoT 化を推し進め、「モノからの通知によって人々の生活を豊かにする」というコンセプトの実現を目指しております。

アプリックスの website (投資家情報等) : <https://www.aplix.co.jp/>

アプリックスのテクノロジー事業 : <https://business.aplix.co.jp/>

Facebook 公式ページ : <https://www.facebook.com/AplixCorporation.official/>

■お問い合わせ先:

お問い合わせのページ : <https://www.aplix.co.jp/inquiry/>

シマフジ電機のお問い合わせページ : <http://www.shimafuji.co.jp/contact>

※ 記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。